

應用六標準差的手法改善個案公司

印刷電路板防焊脫落之不良率

學生：陳典昌

指導教授：童超塵

國立雲林科技大學工業工程與管理研究所碩士班

摘 要

本論文研製之應用六標準差的手法改善個案公司印刷電路板防焊脫落之不良率，主要為六標準差漸漸為現今國內外公司大廠所使用。個案公司為了增加印刷電路板新製造廠商以透過廠商競爭降低成本，而新廠商初期導入生產的過程中發現防焊脫落的比率甚高，約佔異常總數的 61.11%，產品 1PCS 異常的成本損失亦達新臺幣 303 元，因此，個案公司為使後續生產更為順暢以及降低成本，將透過六標準差 D-M-A-I-C(界定-衡量-分析-改善-控制)的流程步驟持續改善防焊脫落之不良。個案公司於專案中發現，原本防焊脫落不良為 378PPM，如經由防焊前處理超粗化與隔焊加大將對於防焊附著力會有影響並經由實際生產後發現防焊脫落不良現象有大幅降低至 95PPM。最後，對於異常現象持續監控，也確認異常現象穩定性的降低並已達到個案公司所設置的目標。

關鍵詞：六標準差、印刷電路板、前處理超粗化、隔焊加大